

## 新北市 113 年度積體電路應用教師研習-電子元件拆錫 課程表

本研習共 2 梯次，每梯次 2 天，請教師選擇下列 1 個梯次報名：

**第 1 梯次日期：**113 年 5 月 04 日(星期六)~113 年 5 月 05 日(星期日)

**第 2 梯次日期：**113 年 5 月 25 日(星期六)~113 年 5 月 26 日(星期日)

報名表單連結：QR-code



日期 時間	第一天 (星期六)	第二天 (星期日)
08:30~09:00	學員報到	
09:00~10:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 始業式</li> <li>● 電子工程與產業鏈結介紹</li> <li>● 電子元件拆錫技職力課程介紹</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 積體電路應用&amp;趨勢講座</li> <li>● 進階銲接(SCBMH)</li> </ul>
10:00~12:00 (彈性下課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 基礎銲接(D1-2)</li> <li>(1) 銲接技巧說明</li> <li>(2) 銲接工具及零件識別</li> <li>(3) 銲接實作</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 主控板銲接實作</li> <li>(2) 主控板測試與檢修</li> <li>(3) 測試板功能檢測</li> </ul>
12:00~13:00	午餐時間	
13:00~16:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 進階銲接</li> <li>(1) 主控板功能介紹</li> <li>(2) 主控板銲接實作</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電子元件拆錫技職力評量</li> <li>(1) 教學評量模擬</li> <li>(2) 教案交流討論</li> </ul>
16:00~	課程結束/賦歸	
備註	含：培訓用：基礎銲接材料 1 套、主控板套件 1 套	